

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-46313

(43) 公開日 平成8年(1996)2月16日

(51) Int.Cl.*	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 5 K 1/14		A		
H 0 1 L 21/60	3 1 1 S	7726-4E		
H 0 5 K 3/36		B		

審査請求 未請求 請求項の数3 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号	特願平6-178404	(71) 出願人	000005223 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
(22) 出願日	平成6年(1994)7月29日	(72) 発明者	山崎 直樹 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
		(72) 発明者	池端 憲治 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
		(72) 発明者	岡田 徹 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
		(74) 代理人	弁理士 松本 昂

(54) 【発明の名称】 パッケージの実装構造

(57) 【要約】

【目的】 本発明はボールグリッドアレイの実装構造に関し、接合部にクラックが発生しにくく製造作業性に優れた実装構造の提供を目的とする。

【構成】 パッケージ2の下面に設けられた複数の半田バンプ4をプリント配線板6上で溶融させることでパッケージ2とプリント配線板6の半田付けを行うようにした実装構造において、パッケージ2の下面の直線上になん少くとも3箇所にダミーバンプ10を設けて構成する。

第1実施例図

